

9月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要.....	4
一、宏观动态.....	5
二、半导体产业动态.....	7
三、 终端市场动态.....	12
(一) 人工智能.....	12
(二) 汽车.....	13
(三) 医疗.....	13
(四) 机器人.....	14
(五) 工业.....	14
四、 存储行情.....	15
(一) 存储行情概览.....	15
(二) 存储品类/品牌现货市场价格趋势.....	15
信息来源.....	19
免责声明.....	21

摘要

2026 年 9 月重点行情趋势	
宏观动态	● 亚洲：AI 需求双向兑现，接单端与出货端同步创纪录 ● 美国：美联储三年来首次加息，AI 投资进入更高资金成本环境 ● 中美：贸易休战再延长两个月，但 AI 芯片与关键技术限制未现实质松动 ● 美国：半导体本土化进一步加速，投资与关税开始绑定
产业动态	● 恩智浦：9 月 28 日起部分料号涨约 10% ● 瑞萨：9 月 发布新涨价函，2027 年 1 月 1 日生效 ● 超威半导体：市值首破 1 万亿美元，同月通知客户 Q4 起部分产品线涨价约 10% ● 德州仪器：9 月 1 日发出年内第三轮调价预告函 ● 安森美：再发涨价函，10 月生效！ ● 村田制作所：9 月 10 日通知九大系列部分料号 MLCC 逐步停产 ● 台积电：8 月营收创纪录，2nm/3nm 扩产提速并重返龙潭 ● 华虹半导体：9 月 1 日公告无锡三期 12 英寸扩产，总投资 69.5 亿美元 ● 博通：AI 营收 167 亿美元同比增 221%，2300 亿美元长期展望点燃 ASIC 超级周期
终端市场	人工智能 ● OpenAI 携手三星深化下一代芯片合作 ● SpaceX AI 孟菲斯 Colossus 2 数据中心正式投运 汽车 ● 理想 i9 纯电旗舰上市交付，第二代纯电平台首发 ● 比亚迪：首款车规级 4nm 智驾芯片璇玑 A3 开启规模化量产 医疗 ● 西门子医疗启用欧洲首座 CdTe 传感器晶圆厂 ● 美敦力与康诺思腾达成战略合作，投资约 7 亿美元 机器人 ● 小鹏机器人产线正式启用，年底冲刺规模量产 工业 ● 阳光电源全线提价 5%—15%，上游功率器件供应趋紧、成本抬升
存储行情	● DRAM Contract：仍处上涨周期，但涨幅开始分化 ● DRAM Spot：交易偏弱，DDR3/DDR4 部分型号回调 ● Server DDR5：RDIMM 供需最强，主流容量价格明显上涨 ● NAND/SSD：Enterprise 结构性偏紧，Consumer 价格与需求走势分化

一、宏观动态

● 亚洲：AI 需求双向兑现，接单端与出货端同步创纪录

AI 需求在亚洲电子业的接单端与出货端同时兑现。接单端，中国台湾地区 8 月外销订单 1029.6 亿美元，同比增 71.4%、环比增 5.1%，首度突破单月千亿美元并创历史新高，为连续第 19 个月正成长，大幅超出主管部门 970 亿至 990 亿美元的预估区间；结构上资讯通信产品增 100.5%、电子产品增 83.9%，两者合计占整体 77.7%，主管部门将超预期归因于 AI 服务器拉货与美国云端服务商自研 ASIC 对当地 IC 设计业的带动，AI 红利亦外溢至机械与基本金属（分别增 28.3%、26.8%）。出货端，韩国关税厅数据显示 9 月 1—20 日出口 714 亿美元、同比增 78.3%，创有统计以来同期 20 天最高，其中半导体出口 341.2 亿美元、同比增 259.4%，占出口比重升至 47.8%、较上年同期提高 24.1 个百分点，解释了总出口增量的约 79%，剔除半导体后出口仍增 22.0%。

● 美国：美联储三年来首次加息，AI 投资进入更高资金成本环境

9 月 16 日，美联储以 12 比 0 票通过加息 25 个基点，将联邦基金利率目标区间上调至 3.75%—4.00%，同步上调准备金利率至 3.9%、贴现利率至 4%，为 2023 年 7 月以来首次加息——此前 2024 年 9 月至 2025 年 12 月已连续 6 次降息，2026 年 1 至 7 月则连续 5 次按兵不动。政策表态的关键变化在于归因：声明删去此前将高通胀部分归咎于“供给冲击”的措辞，转而以“国内支出保持韧性”表述，等于承认需求端亦在推动物价，政策含义从“等待外部冲击消退”转向“主动收紧货币条件”。同步公布的经济预测摘要显示，2026 年底利率中值由 6 月的 3.8% 升至 4.1%、2027 年底维持 4.1%，通胀回归 2% 目标推迟至 2029 年；点阵图显示 18 位官员中 12 人预计年内再加 25 个基点、4 人预计加两次、2 人预计不再加，即 16 人预期年内至少再加一次。主席沃什表示通胀“太高且高得太久”，夏季数据未使其确信潜在通胀出现实质改善。市场反应明显：道指跌 1.21%，10 年期美债收益率重回 5% 以上，美元指数升破 100。对重资产、长回收周期的 AI 基建而言，融资成本上行正成为新的边际约束。

● 中美：贸易休战再延长两个月，但 AI 芯片与关键技术限制未现实质松动

习近平主席 9 月 23 日至 25 日对美国进行国事访问，24 日与特朗普总统在白宫会谈，达成八点成果共识。经贸层面，美财长贝森特 9 月 23 日宣布，原定 11 月 10 日到期的“釜山协议”贸易休战延长两个月至 2027 年 1 月 10 日；商务部 9 月 28

日公布"300 亿对 300 亿"对等降税框架，双方对各自约 300 亿美元进口产品以对等方式降税，其中超过 90% 的产品将免除相互加征的全部关税、享受最惠国待遇，履行各自国内程序后同步实施。但降税清单限定于玩具、家电、农产品、医疗器械等"非敏感"商品；白宫事实清单与中方八点共识也未出现高端 AI 芯片松绑的表述，美方未将先进芯片出口管制纳入本轮人工智能讨论，现行管制措施维持不变。

● 美国：半导体本土化进一步加速，投资与关税开始绑定

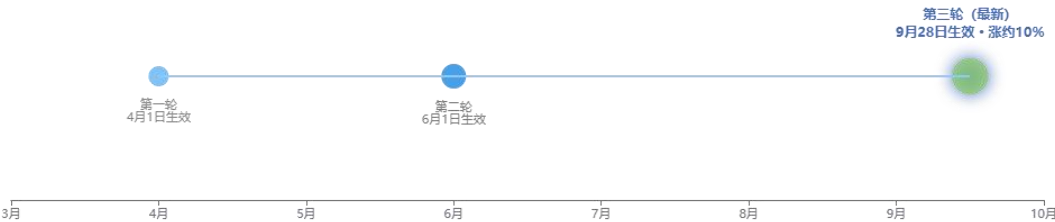
9 月 2 日，中国台湾地区经济主管部门负责人在 SEMICON Taiwan 2026 美国馆开幕式宣布，企业在既有规划外新增约 200 亿美元赴美投资，9 月 3 日进一步确认该金额与美国商务部长卢特尼克接受 CNBC 专访时预告的"下周将宣布 200 亿至 300 亿美元"为同一笔。节奏上，主管部门于今年 5 月 Select USA 峰会前盘点的 20 家企业投资规模为 350 亿美元，三个月内追加 200 亿，累计规划升至 550 亿美元，投资主体集中于半导体供应链与 AI 服务器，并正向生技、能源延伸；需说明的是，此次新增约 200 亿美元投资计划处于年初台美投资 MOU 框架之下；该 MOU 包括 2500 亿美元直接投资及 2500 亿美元信用支持。依双方投资 MOU，企业赴美投资可获得相当于投资产能 2.5 倍的免税进口配额，工厂投产后仍可按新增美国产能的 1.5 倍享受免税额度。配套压力来自关税端——美方正制定新一轮半导体 232 条款关税，覆盖范围可能自芯片本身扩至资料中心服务器与消费电子等含芯片产品，卢特尼克的表述直白："在美国制造，我们给予关税抵减；不在美国制造，将支付关税。"这意味着产能布局与关税成本已被制度性挂钩。

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
厂商	类别	核心数据	趋势
恩智浦 NXP	模拟/嵌入式	9月28日起选定料号涨约10%，年内第三轮	逐料号精细调价
瑞萨 Renesas	MCU / 功率 半导体	调价2027年1月生效； 库存目标升至150天	涨价延续至2027年
超威半导体 AMD	CPU / GPU / AI加速芯片	市值破1万亿美元年内涨186%； Q4部分产品线涨约10%	AI驱动量价齐升
德州仪器 TI	模拟 / 功率 半导体	年内第三轮调价，按料号差异化、无统一涨幅	价格精细化管理
安森美 onsemi	功率 / 模拟 半导体	10月10日起涨价； AI数据中心电源收入2026年翻番以上	功率器件涨价扩散
村田制作所 Murata Manufacturing	被动元件 MLCC	九大系列部分料号停产； 2029年3月底最后出货	产能向高端MLCC倾斜
台积电 TSMC	晶圆代工	8月营收5148亿新台币增53.3%； 资本支出600-640亿美元	先进制程扩产提速
华虹半导体 Hua Hong Semiconductor	晶圆代工	无锡三期月产能5.5万片； 总投资69.5亿美元	特色工艺扩产提速
博通 Broadcom	ASIC定制 / 网络芯片	FY26Q3营收295.91亿增86%； AI半导体167亿增221%	ASIC超级周期开启

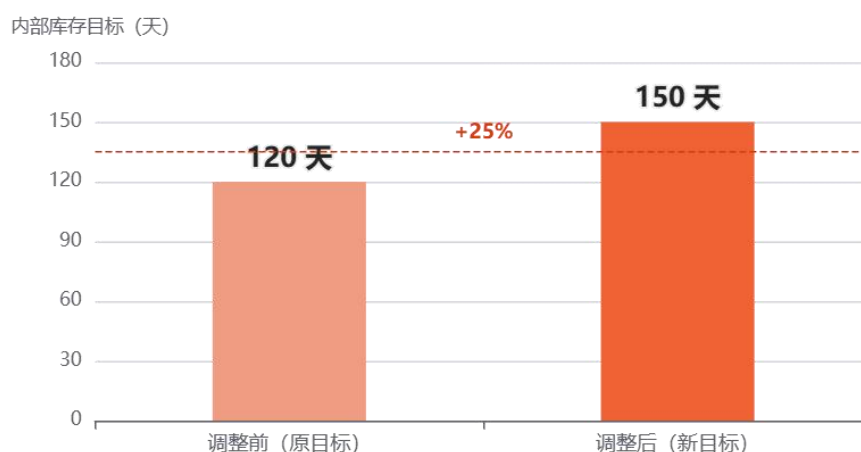
● 恩智浦：9月28日起部分料号涨约10%

据渠道客户函，恩智浦（NXP）已于9月2日向客户发出年内第三轮调价通知，自9月28日起对部分产品组合中的选定料号上调约10%，函件涨价归因于原材料、制造、能源、人工、物流与供应商投入等多环节成本持续上涨。这是NXP年内第三轮调价，前两轮分别于4月1日、6月1日生效。



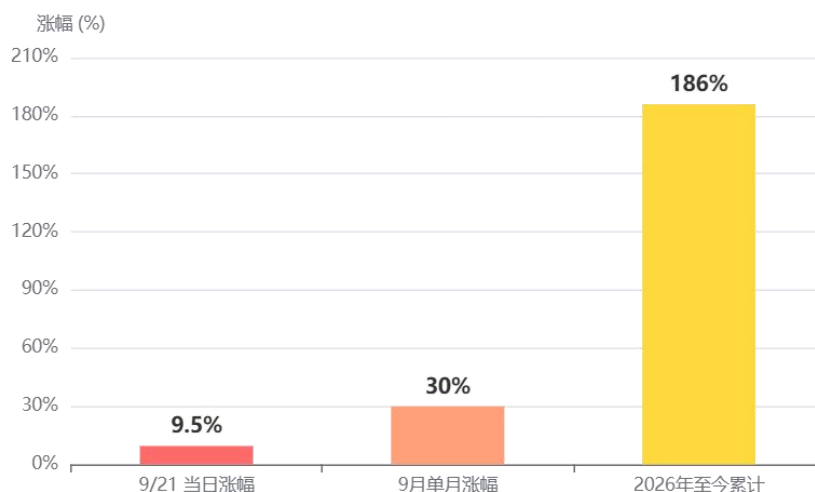
● **瑞萨：9 月 发布新涨价函，2027 年 1 月 1 日生效**

9 月，瑞萨电子宣布对产品价格体系进行调整，新价格将于 2027 年 1 月 1 日正式生效。公司在通知中表示，目前行业仍面临原材料、能源、先进封装、制造产能以及全球物流等方面的结构性成本上涨。此前于 3 月发布通知、7 月 1 日生效。本次调价覆盖公司功率半导体及相关产品。同时瑞萨把内部库存目标从 120 天提高到 150 天，成品、晶圆裸片与原材料储备全面增加。



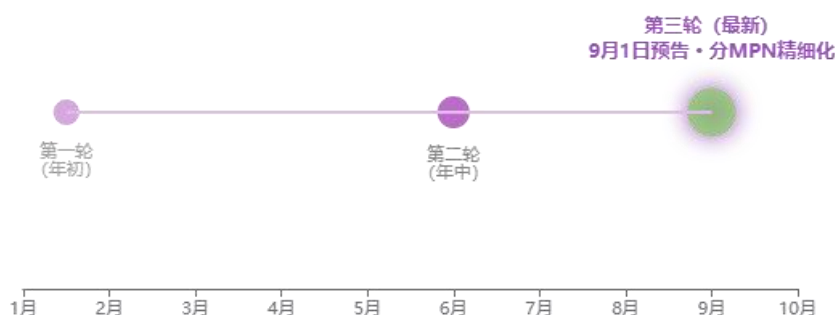
● **超威半导体：市值首破 1 万亿美元，同月通知客户 Q4 起多产品线涨价约 10%**

TrendForce 报道，AMD 已向多家客户通报了约 10%的价格上调，相关调整预计将于 2026 年第四季度生效。涨价涵盖人工智能加速芯片、消费级图形处理器以及主板芯片组。直接原因是台积电已通知客户代工报价上调约 10%，AMD 已开始向下游客户转嫁部分成本。9 月 21 日美股盘中，AMD 涨幅扩大至 9.5%、股价突破 613 美元，总市值首次突破 1 万亿美元，成为继英伟达、博通、美光之后第四家跻身万亿俱乐部的美国半导体企业，今年以来股价累计上涨约 186%、9 月单月涨近 30%。



● 德州仪器：9 月 1 日发出年内第三轮调价预告函

据渠道客户函，德州仪器 9 月 1 日向客户发出年内第三轮调价预告函，由高级副总裁 Mark Roberts 署名，涉及多款模拟及功率产品。此次涨价并非统一幅度，而是分产品、分型号调整，具体涨幅取决于材料、技术和制造工艺。TI 表示，调价由市场动态和供应链成本上升驱动。客户将通过账户后台收到具体料号（MPN）的价格变动通知，显示出此次调价更趋于“精细化”管理，而非“一刀切”。



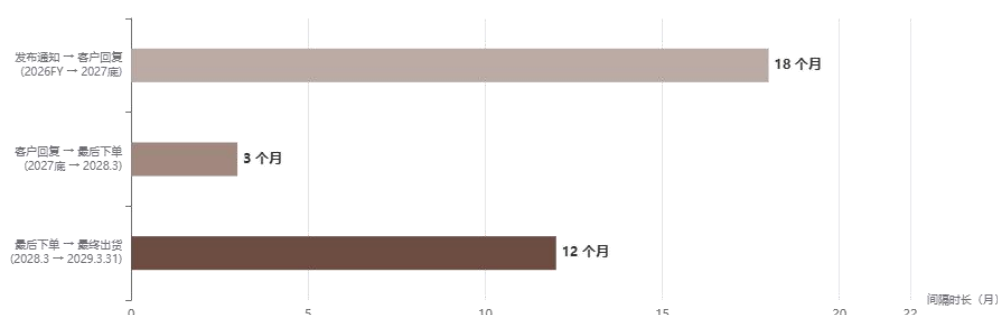
● 安森美：再发涨价函，10 月生效！

9 月下旬，安森美近日发布涨价通知，宣布自 2026 年 10 月 10 日起对产品系列实施价格调整，这是继今年 4 月之后的新一轮调价，未披露具体产品和幅度，原因是成本上涨及电源、工业、数据中心需求增长；公司看好 AI 数据中心电源管理芯片，2025 年该业务收入超 2.5 亿美元，预计 2026 年翻倍以上。



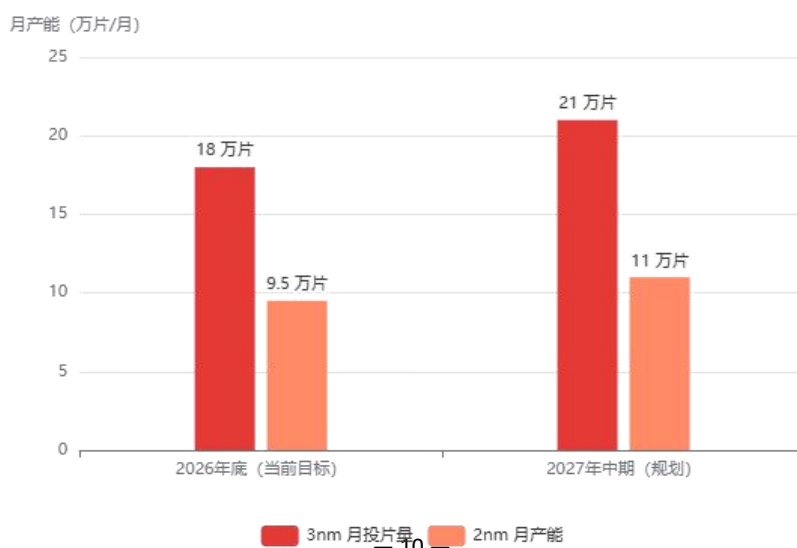
● 村田制作所：9 月 10 日通知九大系列部分料号 MLCC 逐步停产

据客户端收到的产品变更通知（PCN），村田已于 9 月初启动 2026 财年 MLCC 产品线优化，对九个系列中的部分料号执行停产，并告知客户于 2027 年底前完成书面回复，并在 2028 年 3 月底前完成最后下单，最终出货日期为 2029 年 3 月 31 日。据了解本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分 GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG 与 ZRA 系列。另据日经新闻报道，村田副社长南出雅范表示正研讨未来 3 至 5 年含厂房在内的扩产计划，评估“比以往更加大胆”，方案尚处论证阶段。



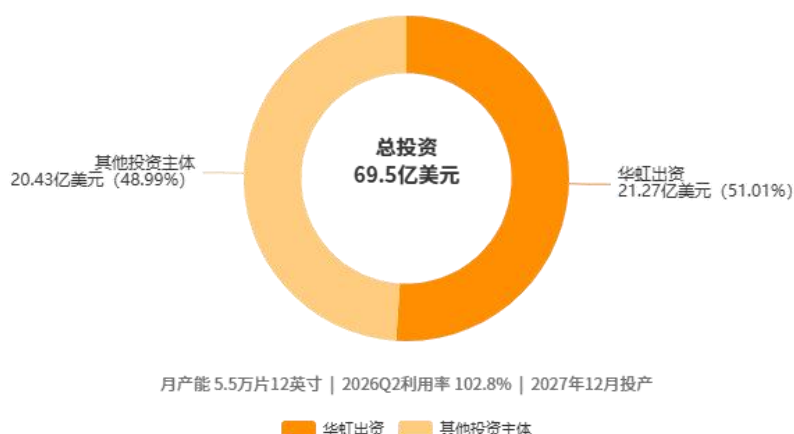
● 台积电：8 月营收创纪录，2nm/3nm 扩产提速并重返龙潭

台积电 9 月先进制程布局全面提速。8 月营收首破 5000 亿新台币，年增 53.32%，连续四个月创纪录；3 纳米年底月投片目标 18 万片有望提前达成，2 纳米五座工厂同步爬坡，年底月产能近 10 万片。资本支出上调至 600 亿至 640 亿美元，3 纳米 2026 下半年涨幅最高 15%。据供应链消息，台积电揭露 2027 年中期扩产规划：2nm 月产能从 2026 年底 9 万片升至 11 万片，3nm 从逾 18 万片升至 21 万片；9 月 17 日再传将重返龙潭，龙科三期锁定 1.4nm 以下先进制程，规划三座晶圆厂，首座 2030 年前后完工，投资超 1 万亿新台币。



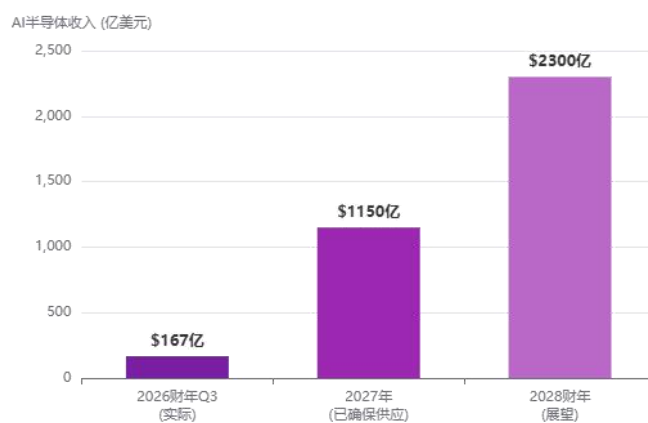
● **华虹半导体：9 月 1 日公告无锡三期 12 英寸扩产，总投资 69.5 亿美元**

9 月 1 日，华虹宏力公告，公司及全资子公司联合多家投资主体，在无锡新建月产能约 5.5 万片的 12 英寸特色工艺晶圆生产线。项目总投资 69.5 亿美元（约合人民币 468 亿元）。项目采用多方联合出资模式，增资完成后标的公司注册资本达 41.7 亿美元。华虹方合计出资约 21.27 亿美元、持股 51%。项目预计 2027 年 12 月完成建设并投产。公司 2026 年第二季度产能利用率达 102.8%。



● **博通：AI 营收 167 亿美元同比增 221%，2300 亿美元长期展望点燃 ASIC 超级周期**

博通 9 月 2 日美股盘后公布 2026 财年第三季度业绩：营收 295.91 亿美元，同比增长 86%；调整后每股收益 3.32 美元，高于市场预期；AI 半导体收入 167 亿美元，同比增长 221%。公司预计第四季度营收约 348 亿美元。到 2027 年已确保供应将 AI 营收翻倍至约 1150 亿美元，2028 财年 AI 半导体营收再翻倍至 2300 亿美元，长期展望点燃 ASIC 超级周期。



三、终端市场动态

终端市场动态概览		
类别	动态	洞察
人工智能	OpenAI 携手三星深化下一代芯片合作，联合研发与生产取得最大进展，扩展至存储与制程。	拉动 HBM、LPDDR、ABF 载板需求，先进封装产能持续紧张。
	SpaceXAI 孟菲斯 Colossus 2 已投运，马斯克称其为全球最大 AI 超级计算机：现有 55 万颗英伟达芯片（11 万 GB200 + 44 万 GB300），年底或增至约 121 万颗。	拉动 800G/1.6T 光模块、高多层 PCB、液冷与电源模块需求。
汽车	理想 i9 纯电旗舰上市，36.98 万元，搭载马赫 M100 智驾芯片、800V 平台与线控转向。	拉动车规 LPDDR5X/UFS、激光雷达 SPAD、SiC 逆变器与 ASIL-D MCU。
	比亚迪璇玑 A3 4nm 车规智驾芯片规模量产，车规芯片已覆盖 13 大类、567 款。	4nm 智驾芯片上车，长期挤压第三方车规 SoC/MCU 在比亚迪份额。
医疗	西门子医疗福希海姆 CdTe 光子计数传感器半导体制造工厂启用，投资约 1 亿欧元，欧洲唯一同类型。	光子计数 CT 上量拉动读出 ASIC、低噪声模拟前端、高压功率器件。
	美敦力向康诺思腾战略投资约 7 亿美元，获 Sentire 手术机器人海外部分市场分销权。	手术机器人双平台放量拉动医疗级 MCU、力传感器、伺服驱动与 ASIC。
机器人	小鹏机器人产线启用，全球首条高阶人形机器人自动化产线，自动化率超 80%，年底量产。	复用汽车电子供应链，新增关节伺服、力矩传感器、AI 芯片散热需求。
工业	阳光电源光储产品全线涨价 5%—15%，9 月 20 日起执行，归因原材料与功率器件成本。	IGBT/SiC 模块、电流传感器、继电器与连接器面临跟涨。

（一）人工智能

● OpenAI 携手三星深化下一代芯片合作

9月9日，OpenAI 韩国总经理 Harrison Kim 在首尔新闻发布会上表示，OpenAI 与三星电子在下一代芯片的研发与联合生产方面取得"最大进展"并获得最广泛认可。今年6月 OpenAI 曾推出首款与博通合作的自研推理芯片，如今将合作版图扩展至存储与制程巨头三星。OpenAI 同时披露，截至8月底韩国企业和机构的 ChatGPT 企业版用户数较一年前增长约 28 倍。

● SpaceXAI 孟菲斯 Colossus 2 数据中心正式投运

SpaceXAI 孟菲斯 Colossus 2 已进入运营。马斯克将其称为全球最大的 AI 超级计

算机。9 月 25 日，他在 X 平台回复用户提问时披露，Colossus 2 现有 11 万颗英伟达 GB200 与 44 万颗 GB300，合计 55 万颗；另 22 万颗 GB300 预计于 10 月初全面投运，11 月再上 22 万颗，若进展顺利 12 月底前再加 22 万颗，届时芯片总数或达约 121 万颗、较当前翻倍以上。他同时披露 Colossus 1 为 15 万颗 H100、5 万颗 H200 与 3 万颗 GB200。

(二) 汽车

● 理想 i9 纯电旗舰上市交付，第二代纯电平台首发

9 月 16 日晚理想发布家庭六座纯电旗舰 SUV 理想 i9，统一零售价 36.98 万元人民币。作为理想汽车第二代纯电平台的首发旗舰，理想 i9 搭载理想自研代工的电池、自研自制的电机、马赫 M100 芯片以及智驾模型。此前，9 月 10 日理想汽车李想宣布 OTA 8.6 推送，通过模型蒸馏将马赫 VLA 2.0 智驾能力下放至近百万辆搭载 Orin、Thor 芯片的老款 AD Max 车型，强调不抛弃老用户，同步更新泊车、座舱及安全电动功能。

● 比亚迪：首款车规级 4nm 智驾芯片璇玑 A3 开启规模化量产

在 9 月 16 日的股东交流会上，比亚迪集团董事会秘书李黔表示，半导体是比亚迪非常重要的能力之一，芯片种类已覆盖 13 大类、567 款车规产品，从功率半导体、模拟芯片延伸至逻辑芯片。他透露，中国首款车规级 4nm 智驾芯片「璇玑 A3」已开启规模化量产，未来公司将持续在设计端与制造端发力。

(三) 医疗

● 西门子医疗启用欧洲首座 CdTe 传感器晶圆厂

2026 年 9 月 11 日，西门子医疗在德国福希海姆启用欧洲唯一同类型半导体制造工厂，专产碲化镉（CdTe）传感器，用于光子计数 CT。工厂投资约 1 亿欧元、面积约 9500 平方米、新增 100 余岗位，2023 年开工现已竣工。此举旨在降低对日本单一基地依赖，因日本工厂产能已接近上限。新厂覆盖晶体生长至像素光刻全流程，并以

LEED 铂金级碳中和方式运营。

- **美敦力与康诺思腾达成战略合作，投资约 7 亿美元**

9 月 1 日，美敦力宣布与康诺思腾达成战略合作，将向其投资约 7 亿美元，并获得 Sentire 手术机器人在美国以外部分已获批市场的分销权。Sentire 由康诺思腾全栈自研，已于 2026 年 5 月获欧盟 CE 认证，并在中国和新加坡获批，适用于普外、妇科、胸科及泌尿科微创手术。美敦力将把 Sentire 与其自研 Hugo RAS 系统组成双平台组合，成为唯一提供该组合加手术生态系统的公司。

(四) 机器人

- **小鹏机器人产线正式启用，年底冲刺规模量产**

2026 年 9 月 8 日，小鹏机器人生产线正式启用，全球首位高阶通用人形机器人完成自动化总装并自主走下产线，标志着小鹏完成从研发试制到产线制造的关键跨越。该产线为全球首条高阶人形机器人自动化产线，核心制程自动化率超 80%，以车规级一致性标准打造量产品质体系。小鹏机器人全身 76 个自由度，单手 21 个自由度，搭载 3 颗图灵 AI 芯片，有效算力达 2250 TOPS，无需遥操即可自主完成复杂任务。小鹏计划 2026 年底进入规模量产阶段，2027 年面向中国及海外市场正式上市交付。

(五) 工业

- **阳光电源全线提价 5%—15%，上游功率器件供应趋紧、成本抬升**

阳光电源 9 月 11 日发调价告知函，光伏逆变器、储能变流器及储能系统等产品进行价格调整，整体涨幅为 5%—15%，新价格将于 9 月 20 日起正式执行。阳光电源在调价函中，将此次涨价主要归因于上游原材料价格上涨、供应链成本增加以及核心零部件供应趋紧。受上游铜、铝等原材料价格上涨（2026 上半年铜、铝同比分别涨 31.4%、18.8%）以及 AI 算力挤占 IGBT/SiC 产能影响，上游功率器件供应趋紧、成本抬升。

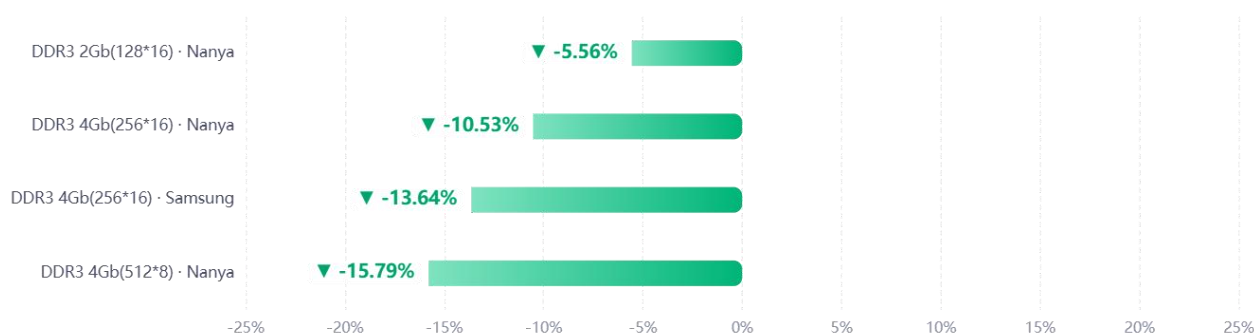
四、存储行情

(一) 存储行情概览

- **DRAM Contract:** 仍处上涨周期，但涨幅开始分化
- **DRAM Spot:** 交易偏弱，DDR3/DDR4 部分型号回调
- **Server DDR5:** RDIMM 供需最强，主流容量价格明显上涨
- **NAND/SSD:** Enterprise 结构性偏紧，Consumer 价格与需求走势分化

(二) 存储品类/品牌现货市场价格趋势

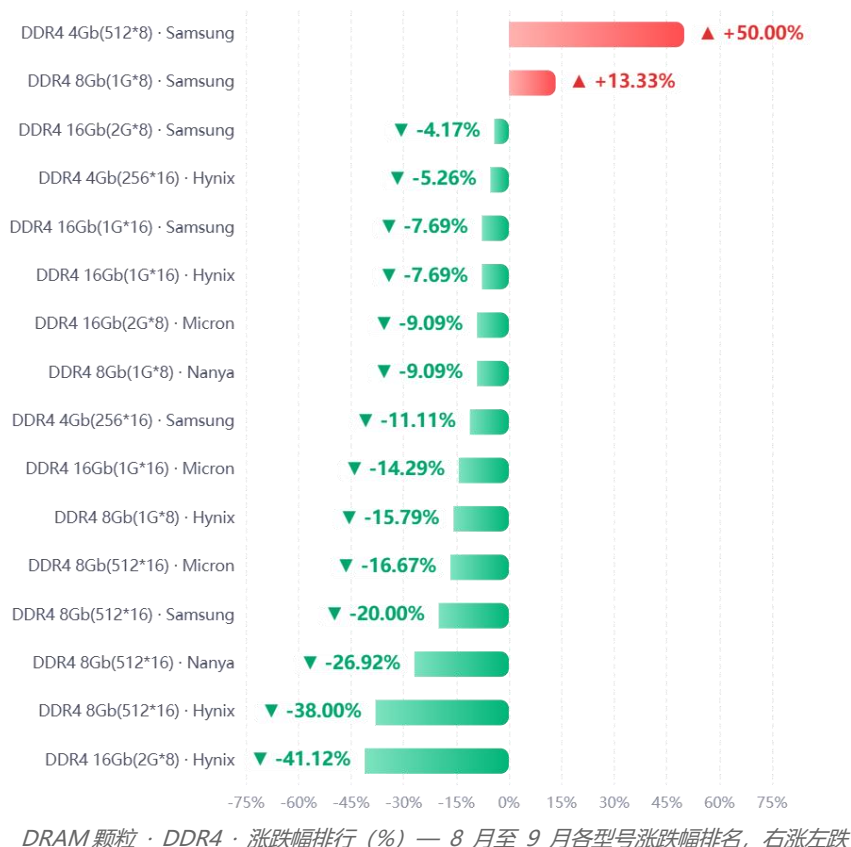
- **DRAM 颗粒 (DDR3)：** 主流规格普遍小幅下行
- DDR3 颗粒本月延续弱势，主流规格普遍小幅下调，仅个别型号持平；预计仍将缓慢下探，但绝对价位已低，下行空间相对有限。



DRAM 颗粒 · DDR3 · 涨跌幅排行 (%) — 8 月至 9 月各型号涨跌幅排名，右涨左跌

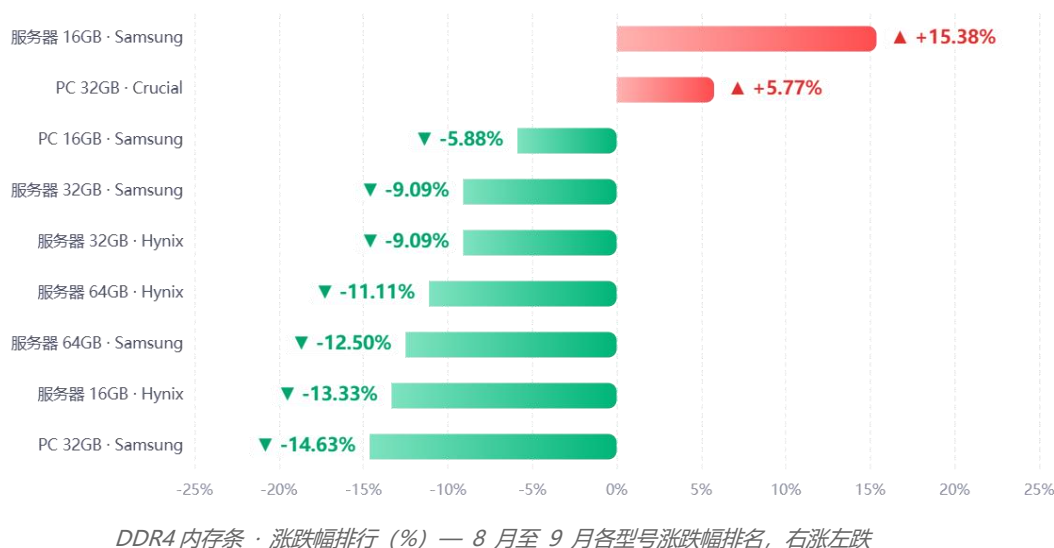
● DRAM 颗粒 (DDR4)：多数规格回调，个别规格逆势上调

- DDR4 本月报价以下行为主：发生变动的型号多数回落，跌幅相对集中于 8Gb、4Gb 等中低容量，相较 8 月高容量普遍上调的表现，本月动能有所减弱。



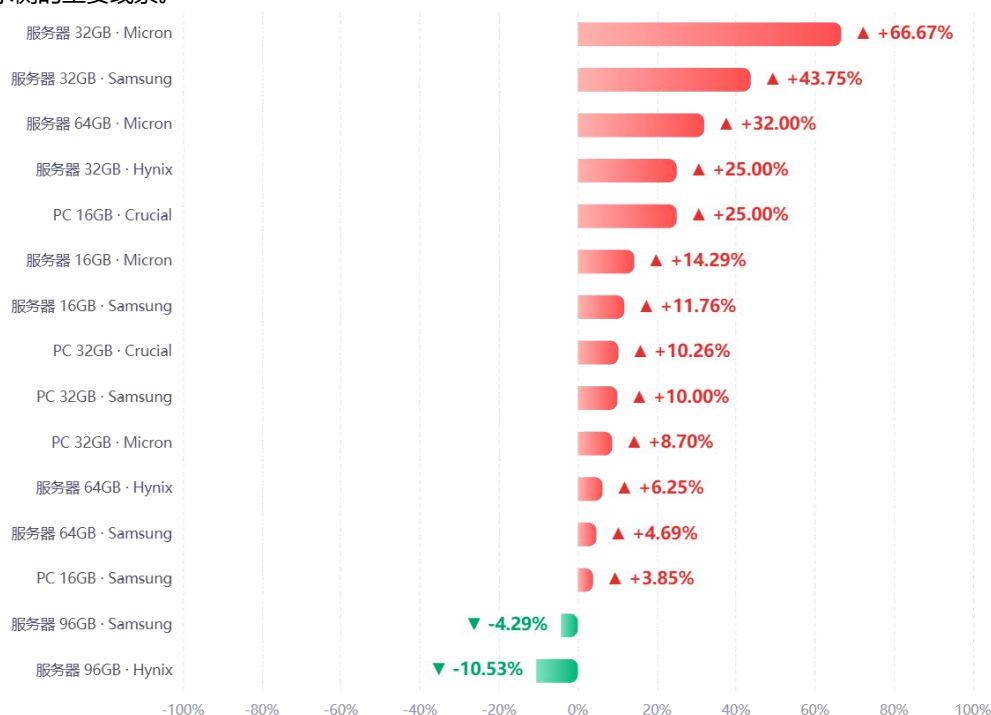
● DDR4 内存条：涨跌互现，服务器主流容量普遍回调

- DDR4 内存条本月涨跌互现：服务器端 64GB、32GB 主流规格普遍下调，16GB 出现分化(Samsung 上调、Hynix 下调)；PC 端多数规格持平。DDR5 渗透率提升带来的需求收缩或是长期背景。



● DDR5 内存条：服务器主流容量普遍大涨，平均涨幅居各品类首位

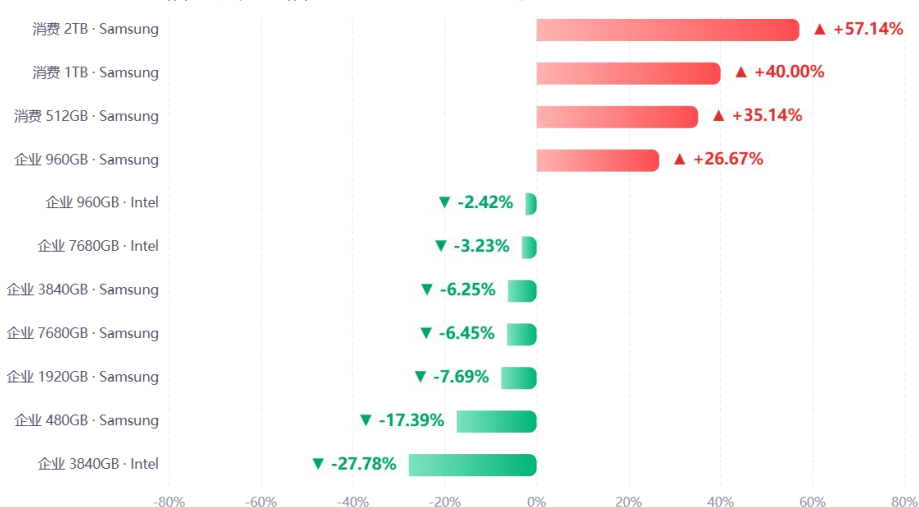
- DDR5 本月平均涨幅在各品类中居首：服务器 32GB、64GB 主流容量普遍大幅上调，单型号最高涨幅超过 60%。上涨主要集中在原厂与数据中心采购的主流容量段，AI 服务器与新一代平台放量是需求侧的主要线索。



DDR5 内存条 · 涨跌幅排行 (%) — 8 月至 9 月各型号涨跌幅排名，右涨左跌

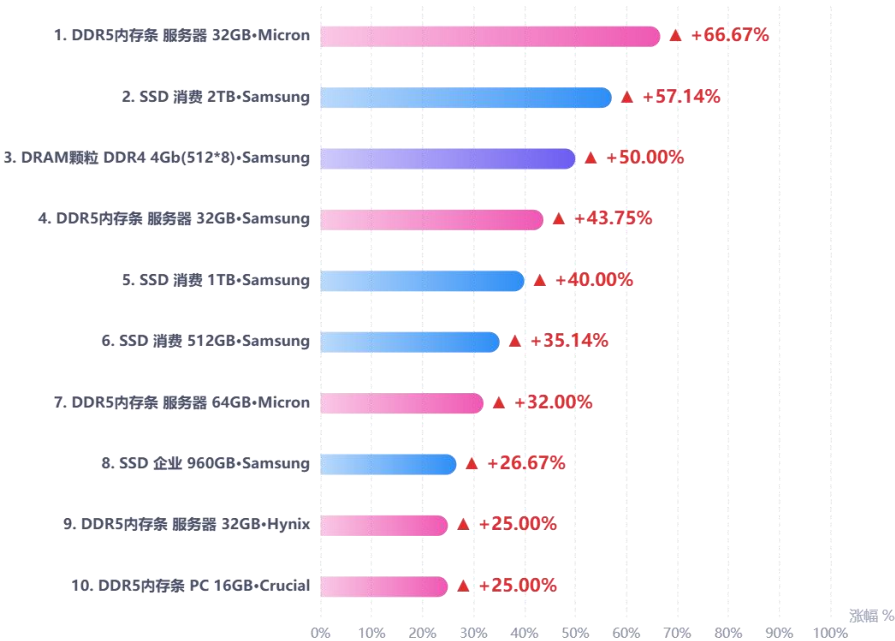
● SSD：企业级高位回落，消费级普遍上调

- SSD 本月呈现两个方向：企业级大容量多数回落，其中 Intel 3.84TB 下调幅度最大；消费级 512GB~2TB 全线大幅上调，涨幅在 35%~57% 之间。



SSD · 涨跌幅排行 (%) — 8 月至 9 月各型号涨跌幅排名，右涨左跌

● 9月涨幅 TOP10 总排行榜



按 8→9 月涨幅排名, 右侧数字为 8 月至 9 月的涨幅

*以上数据截至 2026 年 9 月, 受市场供需影响, 价格浮动明显, 数据仅作参考

信息来源

- [1] 科技新信号, OpenAI 携手三星深化下一代芯片合作, 2026.9.9
- [2] 算力之家, SpaceX AI Colossus 2 数据中心投运: 算力规模约 946 MW, 成为全球最大 AI 数据中心, 2026.09.05
- [3] 理想汽车, 全新理想 i9 正式发布, 2026.09.16
- [4] 易车, 售 36.98 万, 搭理想自研电池+自研自制电机+马赫 M100 芯片+智驾模型, 全新理想 i9 Home 上市! , 2026.09.17
- [5] IT 之家, 比亚迪董秘李黔: 未来会继续在半导体领域投入和发力, 中国首款车规级 4nm 智驾芯片璇玑 A3 已开启规模化量产, 2026.09.17
- [6] 西门子, 西门子医疗在福希海姆启用光子计数传感器半导体制造工厂, 2026.09.16
- [7] Medtronic , Medtronic Announces Strategic Partnership with Cornerstone Robotics to Further Expand Global Access to Robotic-Assisted Surgery, 2026.09.01
- [8] 小鹏汽车, 小鹏机器人生产线正式启用, 全球首位高阶通用人形机器人完成自动化总装并自主走下产线, 2026.09.09
- [9] 财经头条, 最高涨 15%, 阳光电源发布光储调价函! , 2026.09.15
- [10] EETimes, 記憶體價格持續受 AI 伺服器需求支撐惟漲幅收斂, 2026.09.01
- [11] EEPW, 存储芯片市场走势分化: DRAM 强势不改, NAND 面临修正压力, 2026.09.10
- [12] CFM, 宏碁陈俊圣: 当前存储供应并不短缺, 市场报价处于“高位震荡期”, 明年成本有望回落, 2026.09.20
- [13] 证券时报, 美股芯片巨头, 重大发布! 股价盘后巨震, 2026.9.21
- [14] 半导体产业纵横, 疯狂的台积电: 3 纳米卖爆, 20 座厂在建, 展望后摩尔时代, 2026.09.12
- [15] 财联社, 功率半导体涨价潮延续 瑞萨电子新一轮调价明年起生效, 2026.09.10
- [16] 半导体行者, MLCC 龙头, 停产部分产品! , 2026.09.10
- [17] 半导体产业纵横, MLCC 龙头“大胆”扩产, 供需格局要洗牌了? , 2026.09.20
- [18] 新浪财经, AMD 全系列芯片涨价 10%! 显卡、主板、CPU 都跑不掉, 2026.09.18
- [19] 智核漫游, 德州仪器年内第三轮涨价: 模拟芯片“涨价潮”全面蔓延, 2026.09.23
- [20] 新浪财经, 较今年三季度涨 3 成至 4 成! 苹果接受三星明年一季度存储报价,

2026.09.15

[21] 芯语, 台积电首次披露 2nm/3nm 扩产目标, 2nm 明年中月产能 11 万片增 22%, 3nm 21 万片增 16%, 2026.09.15

[22] 36kr, 台积电拟重返龙潭设厂, 优先锁定 1.4 纳米以下制程, 2026.09.18

[23] EE Times, 华虹宏力 468 亿元扩建无锡 12 英寸产线, 月增 5.5 万片产能, 2026.09.04

[24] 人民快讯, 华虹宏力: 拟与全资子公司等共同增资无锡华虹宏力三期半导体有限公司, 2026.09.01

[25] 证券时报, 行业步入高景气周期 功率半导体迎涨价潮, 2026.09.22

[26] SMCEmail, 瑞萨库存目标从 120 天提高到 150 天: 功率半导体供应链“预防式囤货”, 2026.09.15

[27] 36kr, 显示器也开始涨价了, 2026.09.20

[28] 洲际海外, 欧盟更新两用物项管制清单! 电子与半导体进一步扩围, 2026.09.17

[29] TrendForce, 据报道, 随着台积电成本上涨, AMD 计划在 26 年第四季度将 GPU、AI 芯片及芯片组价格上调 10%, 2026.09.18

[30] 台湾地区经济主管部门, Export Orders in August 2026, 2026.09.22

[31] YONHAP NEWS AGENCY, (LEAD) Exports up 78 pct in first 20 days of Sept. on robust chip shipments, 2026.09.21

[32] 中评网, 龚明鑫证实台厂追加 200 亿美元赴美投资, 2026.09.03

[33] Federal Reserve, Federal Reserve issues FOMC statement, 2026.09.16

[34] Federal Reserve, September 16, 2026: FOMC Projections materials, accessible version, 2026.09.16

[35] Newswires, Elon Musk Looks to Rapidly Scale Colossus 2's Nvidia Chip Count, 2026.09.25

[36] 南方都市报, 美方将对玩具、家电等约 300 亿美元自华进口商品降低关税, 2026.09.28

[37] 新华社, 习近平同美国总统特朗普会谈, 2026.09.25

[38] 中国新闻网, 国际舆论关注习近平访美: 传递积极务实信号 推动双边关系发展, 2026.09.27

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2026 年 9 月

360iC 安芯易



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有7个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。

